

スーパーコンピュータに使用された セラミック多層回路基板

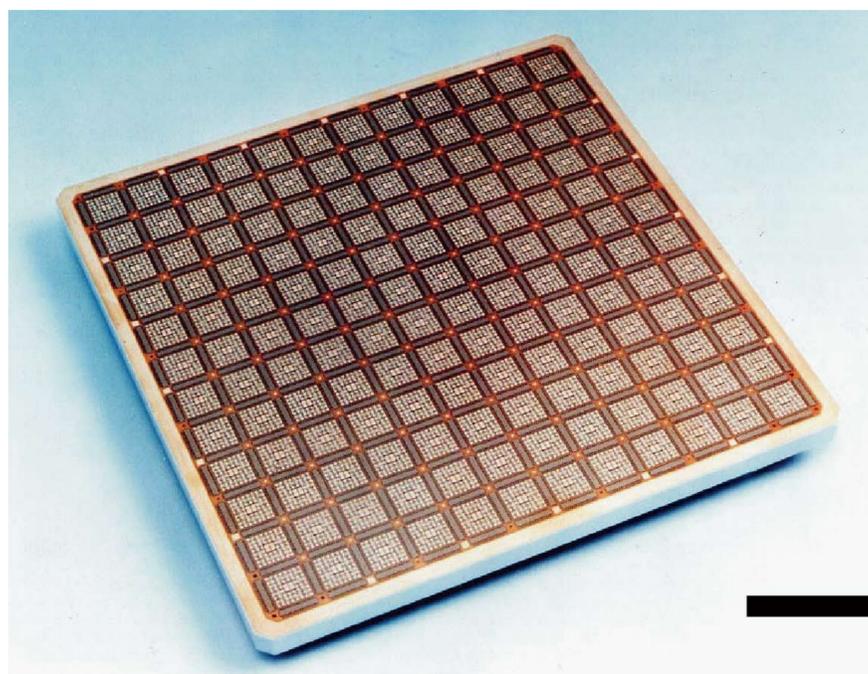
多くの半導体チップを相互に電氣的に接続させるために取り付ける配線基板

多層セラミック回路基板は、1990年代初頭にピークを迎えた日米のコンピュータメーカーによるスーパーコンピュータ)の性能競争の末、配線基板の高速化要求に応じて生まれたものである。セラミックスがもつ材料特性（低熱膨張特性）と製造プロセス性（ビア形成、多層化プロセス）が従来から使用されていた樹脂基板に比べ優れており、LSIの高密度実装化、基板の大型・多層化を実現した高速セラミック回路基板が実用化された。この製品技術は、現在では、高周波機能部品、基板、パッケージ等に形を変え、生きつづけている。

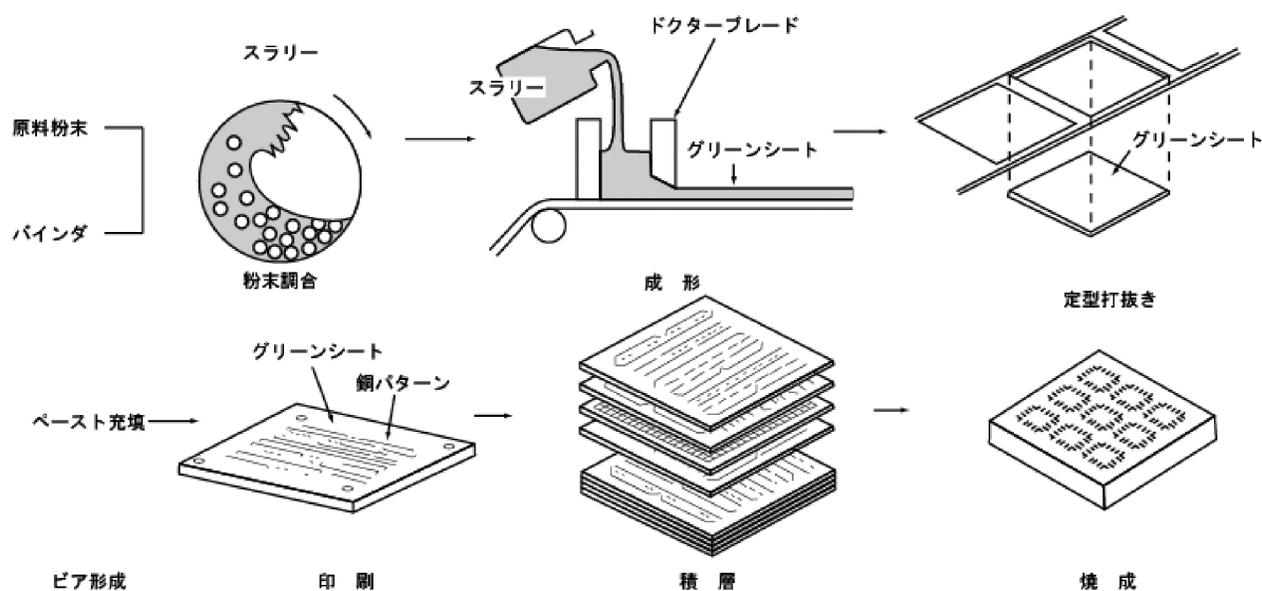
スーパーコンピュータの外観



多層セラミック回路基板の外観 (Bar=50 mm)



多層セラミック回路基板の製造プロセス



■多層セラミック回路基板 (1994年 (株)富士通研究所)

協力：(株)富士通研究所